## РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛИТКОВ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ МИКРО, НАНО ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОВОЛЬТАИКИ

Оксанич А. П. $^{1}$ , д.т.н., проф.; Притчин С. Э. $^{1}$ , к.т.н., доц.; Тербан В. А. $^{2}$ , к.т.н., доц.

<sup>1</sup> Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского, м. Кременчуг, Украина <sup>2</sup> ЧП «Галар», м. Светловодск, Украина

Арсенид галлия (GaAs) является важным полупроводником, третьим по масштабам использования в промышленности после кремния и германия. Широкое применение GaAs находит в фотовольтаике, как в виде солнечных батарей для космического применения, фотогальванических ячеек наземного применения, в гетороструктурных и каскадных элементах солнечных батарей. GaAs очень чувствительным к условиям выращивания, которые и определяют уровень внутренних механических напряжений и плотность дислокаций в нем [1].

Решение задачи повышения качества монокристаллического арсенида галлия в слитках мы видим в разработке новых устройств и систем выращивания слитков, и усовершенствовании существующих технологий, особенно для слитков диаметром  $4^{\prime\prime}$ .

Можно выделить следующие направления усовершенствования технологии:

разработка нового теплового узла обеспечивающего низкие температурные градиенты; совершенствования системы управления процессом выращивания; разработка системы измерения диаметра слитка в процессе выращивания; разработка системы измерения внутренних напряжения в пластинах GaAs.

Особо важную роль в получении структурно-совершенных слитков арсенида галлия играет система управления. Самым важным информационным параметром для системы управления является диаметр слитка, который необходимо измерять в процессе роста. Нами было разработано устройство измерения диаметра слитка по весовому методу. В результате была достигнута абсолютная точность измерения диаметра слитка в процессе выращивания  $\pm 1.0$  мм.

Для решения задачи регулирования диаметра слитка авторами было предложено использовать канал фонового нагревателя с регулятором, работающем по методу прогнозного управления [2].

Тепловой узел является определяющим элементом ростовой установки. Формируемое этим узлом тепловое поле в основном определяет параметры, структурное совершенство и выход готовой продукции. Для решения задачи создания теплового узла с пониженными осевыми градиентами

нами была разработана математическая модель теплообмена на поверхности слитка и разработана методика оптимизации размеров и расположения теплового экрана ростовой установки. Результатом этих работ явилась разработка теплового узла, который позволяет снизить осевые температурные градиенты до 51...53 К/см и обеспечить равномерное распределение температуры по оси выращиваемого слитка.

Для решения задачи определения величины и распределения внутренних напряжений мы использовали хорошо зарекомендовавший себя метод фотоупругости, который реализуется на разработанном нами усторойстве

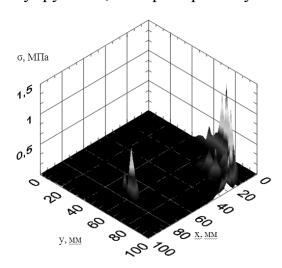


Рис.1. Внутренние напряжения в пластине GaAs измеренные устройством «Полярон М»

«Полярон М». Обеспечить высокую точность измерения внутренних напряжений удалось при использовании гелий—неонового лазера на длину волны 3,13 мкм и фотоприемника на основе сульфида свинца.

Полученное распределение напряжений в пластине арсенида галлия диаметром 100 мм на рисунке 1.

Выводы: 1. Разработаны устройства и системы позволяющие выращивать слитки арсенида галлия диаметром до 100 мм, со следующими характеристиками: номинальный диаметр слитка, мм до

100; подвижность носителей заряда, см $^2$  В $^{-1}$  с $^{-1}$  — 2500 ÷ 3500; концентрация свободных носителей заряда, см $^{-3}$  —  $5 \times 10^{17}$  ÷  $5 \times 10^{18}$ ; плотность дислокаций, см $^{-2}$  — до  $8 \cdot 10^4$ .

- 2. Разработан тепловой узел, позволяющий снизить температурные градиенты до 51...53 K/cm;
- 3. Разработан оптимальный прогнозный регулятор по каналу фонового нагревателя, обеспечивающий точность поддержания диаметра ±2мм;
- 5. Разработано устройство измерения внутренних напряжений в пластинах арсенида галлия.

## Література

- 1. Atanassova E. D. Effect of active actions on the properties of semiconductor materials and structuctures / E. D. Atanassova, A. E. Belyaev, R. V. Konakova et. al. Kharkiv, NTC «Institute of Single Crystals», 2007, 216 p.
- 2. Antonov V. A. Analysis of crystal-meniscus system behaviour under Czochralski crystal growth / V. A. Antonov. // J.Crystal Growth. 2001. v.226. P. 555 561